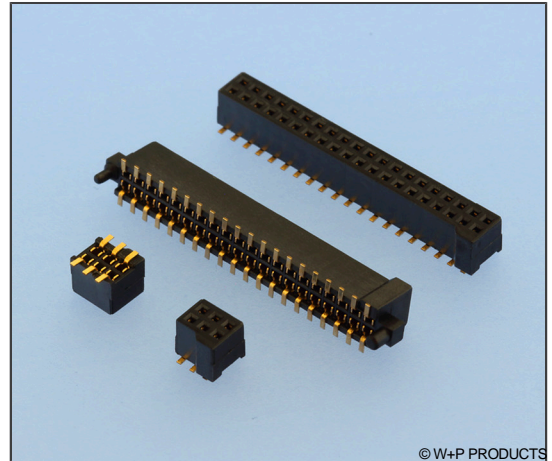


SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig – BH 3,6/4,5mm, durchsteckbar SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row – 3.6/4.5mm Profile, Pass Through

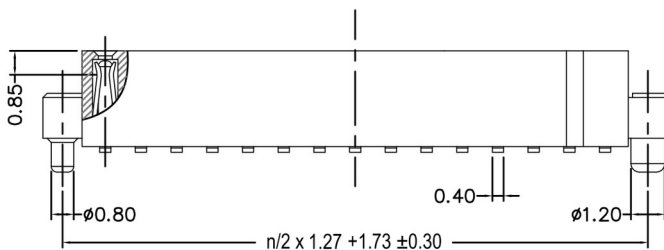
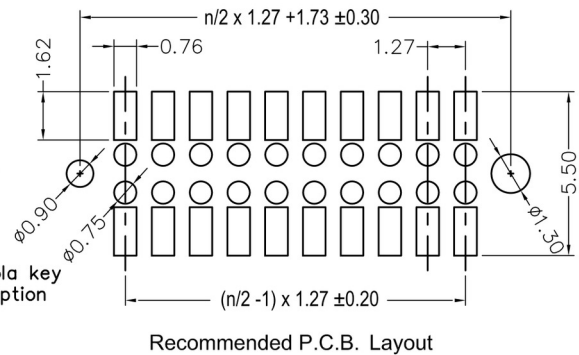
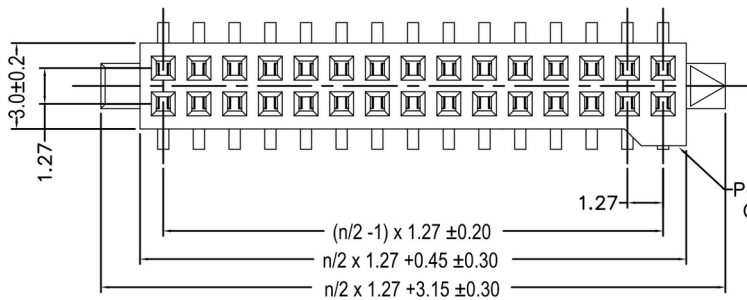
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1 GΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Kurzes Reflow-Lötverfahren <i>Fast reflow soldering</i>



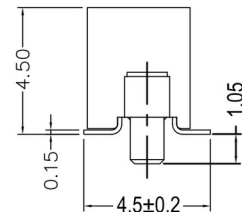
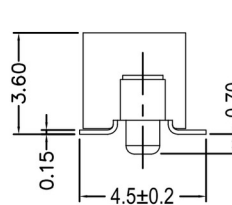
© W+P PRODUCTS

Passende Wannestiftleisten:
Compatible Box Headers:
6110. 6111



Profile -36-

Profile -46-



Series	Contacts*	Profile*	Plating	Location Pegs*	Polarization Key*	Packaging*
6067	030 006-100 Zweireihig Double row	36 36 Bauhöhe 3,6mm 3.6mm profile 46 Bauhöhe 4,5mm 4.5mm profile	00 Vergoldet Gold plated	10 00 Ohne Loc. pegs W/o loc. pegs 10 Mit Loc. pegs With loc. pegs	10 00 Ohne Pola.key W/o pola.key 10 Mit Pola.key With pola.key	TR TR PPTR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

TR Tape & Reel ohne P&P-Pads / Tape & Reel w/o P&P-Pads
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min

